

性能特点

- 本系列灌封胶适用于各种灌封模式
- 应力低，更为有效地保护电器元件
- 100%固态，固化后无渗出物
- 优越的耐高低温性，极好的耐候性，耐辐射及优越的介电性能
- 化学性能和机械性能稳定

产品描述

PAKCOOL® TPC-200 是 1:1 双组分液态电子透明灌封材料，可在室温或加温固化。本产品具有耐高低温性和绝缘性高等特点，固化后胶体应力低，从而更有效地消除电子元器件因工作温度变化产生的破坏作用。本产品适用于激光器的双层包光纤在铝光纤盘上的灌封固定。由于本产品不亲水，具有防潮的特点，可有效的减缓潮气对外层的影响，延缓光纤寿命。本产品固化前有优良的流动性和流平性，固化后的胶料无挥发物生成。本产品的固化体系具有很好的抗毒性，在一般情况下无须对焊锡及涂料等作特殊处理。

典型应用

- LED 组装
- 逆变器
- 高频变压器
- 电源模块
- 汽车电池包
- 通讯设备
- 电子部件

注意事项

- 本产品接触有些物质可能会不固化或不完全固化，这些物质包括：硫、磷、氮的化合物如聚砒、聚硫醚、聚氨酯、含酰胺、胺的物质，含锡、砷、锑、硒、碲成分的物质及一些不饱和的碳氢化合物及增塑剂等
- 因为 A/B 组分的粘度略有差异，如采用机器灌封，需对 B 组分的压力略做调整
- 存放过程中，产品会有填料沉降，属于正常现象，使用前需要将 A、B 组分在各自的桶内刮底刮壁充分搅拌均匀后，再以 1:1 进行混合，并充分搅拌均匀

技术参数

特性	TPC-200	测试方法
基材	双组分 RTV	--
颜色	A:无色透明 B:无色透明	Visual
A/B 混合比例	1:1	--
粘度 (cP)	A:≤3000 B:≤5200	ASTM D2196-20
操作时间 (min @ 25°C)	>20	--
导热系数 (W/m·K)	-	ASTM D5470
硬度 (Shore OO)	25±5	ASTM D2240
密度 (g/cm ³)	0.97±0.10	ASTM D792
介电强度 (kV/mm)	≥18	ASTM D149
体积电阻率 (Ω·cm)	≥3.0x10 ¹³	ASTM D257
保质期 (@室温)	6 个月	--
连续使用温度 (°C)	-50 至+200	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

储存条件

- PAKCOOL® TPC-200 需阴凉干燥处储藏

包装规格

- 500g/罐、5Kg/桶和 10Kg/桶的包装规格，并可根据客户需求定制

固化时间

- TPC-200 硅胶在 25°C 下固化 4 小时即可不流动，可搬运下一步工序。其交联（完全固化）的时间将随温度升高而缩短（参见下表）。

25°C	72 小时
70°C	20 分钟

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。